

<<印制电路用覆铜箔层压板新技术>>

图书基本信息

书名：<<印制电路用覆铜箔层压板新技术>>

13位ISBN编号：9787508434971

10位ISBN编号：7508434978

出版时间：2006-1

出版时间：水利水电出版社

作者：祝大同

页数：361

字数：426000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<印制电路用覆铜箔层压板新技术>>

内容概要

覆铜板(CCL)是电子信息工业的重要基础材料。

主要用于制造印制电路板(PCB), 广泛应用在家电、计算机、通信设备、半导体封装等电子产品中。本书通过32篇专题文章, 详细阐述、讨论了在覆铜板适应PCB的高密度化、高频高速化、环保绿色化等需求方面, 它的制造原材料、新产品、新技术的世界最新进展。

本书适合于印制电路板及其基板材料制造业, 以及电子信息、通信、化工、复合材料、微电子等领域的工程技术人员参考阅读。

<<印制电路用覆铜箔层压板新技术>>

书籍目录

序言覆铜板用新材料篇 覆铜板用新型材料的发展(一) ——新型树脂材料 覆铜板用新型材料的发展(二) ——覆铜板用芳酰胺纤维无纺布 覆铜板用新型材料的发展(三) ——覆铜板用高性能铜箔 覆铜板用新型材料的发展(五) ——新型玻璃纤维布 覆铜板用新型材料的发展(七) ——新型玻璃纤维纸 PCB基板材料用BT树脂 低介电常数电路板用烯丙基化聚苯醚树脂 新型酚醛树脂固化剂 ——从日本专利看PCB基板材料制造技术的新发展之五 PCB用高性能铜箔的新发展 PCB基板材料树脂中的新型填料运用 ——从日本专利看PCB基板材料制造技术的新发展之二覆铜板新产品开发篇 PCB基板材料走向高性能、系列化(1) ——对日本近年环氧玻纤布基的基板材料开发的实例剖析 PCB基板材料走向高性能、系列化(3) ——对日本近年银浆贯孔用纸基覆铜板开发的实例剖析 PCB基板材料走向高性能、系列化(4) ——对日本近年酚醛纸基覆铜板开发的实例剖析 PCB基板材料走向高性能、系列化(10) ——对日本近年高精度、极薄型基板材料开发的实例剖析 高速、高频PCB用基板材料的技术发展与评价 PCB用高耐热性基板材料的技术进展 构成PCB绝缘层用树脂薄膜 ——从日本专利看PCB基板材料制造技术的新发展之一 PCB用无卤化基板材料 ——从日本专利看PCB基板材料制造技术的新发展之三 适于CO₂激光钻孔加工的基板材料 ——从日本专利看PCB基板材料制造技术的新发展之四 埋入电容基板用高e覆铜板的技术进展 ——从日本专利看PCB基板材料制造技术的新发展之六 挠性: PCB用基板材料的新发展(1) ——FCCL的发展与特点综述 挠性PCB用基板材料的新发展(2) ——三层型挠性覆铜板的开发新成果 挠性PCB用基板材料的新发展(3) ——二层型挠性覆铜板的开发新成果 挠性PCB用基板材料的新发展(4) ——FPC用压延铜箔的新成果 挠性PCB用基板材料的新发展(5) ——FPC用电解铜箔的新成果覆铜板前沿技术发展篇 基板材料对PCB残留应力的影响 ——PCB基板材料性能的有关理论探讨之 现代覆铜板的技术开发 对未来我国覆铜板业技术发展的战略与任务的探讨 对积层法多层板用基板材料技术发展的探讨 无卤化CCL开发技术的新进展 ——对近年相关内容的日本专利的综述 无卤化FR-4树脂用酚醛树脂固化剂的技术发展 对适应无铅化FR-4型覆铜板技术的探讨后记

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>